

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Fibre optic active components and devices – Reliability standards –
Part 3: Laser modules used for telecommunication**

**Composants et dispositifs actifs en fibres optiques – Normes de fiabilité –
Partie 3: Modules laser utilisés pour les télécommunications**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2011 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: csc@iec.ch

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: csc@iec.ch

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Fibre optic active components and devices – Reliability standards –
Part 3: Laser modules used for telecommunication**

**Composants et dispositifs actifs en fibres optiques – Normes de fiabilité –
Partie 3: Modules laser utilisés pour les télécommunications**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

R

ICS 31.260; 33.180

ISBN 978-2-88912-726-9

CONTENTS

FOREWORD.....	3
INTRODUCTION.....	5
1 Scope.....	6
2 Normative references	6
3 Terms, definitions and symbols	6
3.1 Terms and definitions	6
3.2 Symbols	7
4 Laser reliability and quality assurance procedure	8
4.1 Demonstration of product quality	8
4.2 Testing responsibilities	8
4.2.1 General	8
4.2.2 Recommendation applicable to laser customer/system supplier	8
4.2.3 Recommendation applicable to system operator	8
4.3 Quality improvement programmes (QIPs)	8
5 Tests	9
5.1 General	9
5.2 Structural similarity.....	9
5.3 Burn-in and screening (when applicable in the specification)	9
6 Activities.....	13
6.1 Analysis of reliability results	13
6.2 Technical visits to LMMs	13
6.3 Design/process changes	14
6.4 Deliveries	14
6.5 Supplier documentation.....	14
Annex A (informative) Guidance on testing in Table 1 and Table 2.....	15
Table 1 – Initial qualification.....	10
Table 2 – Maintenance of qualification	12
Table 3 – Performance for laser module reliability parameters	13
Table A.1 – Recommended life test conditions for laser modules containing Peltier coolers.....	15
Table A.2 – Recommended life test conditions for uncooled laser modules	16
Table A.3 – Recommended laser diode life test conditions.....	16
Table A.4 – Recommended photodiode life test conditions.....	17

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES –
RELIABILITY STANDARDS –****Part 3: Laser modules used for telecommunication**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62572-3 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic systems and active devices of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
86C/1022/FDIS	86C/1035/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 62572-3:2011

Withdrawn

INTRODUCTION

The laser modules covered by this International Standard are purchased by system suppliers (SS) to be inserted in equipment which in turn are supplied/sold to a system operator (SO) or a network operator (see definitions in Clause 3).

For the system operator to act as an informed buyer, knowledge of the potential risks posed by the use of critical components is required.

Optoelectronic component technology is continuing to develop. Consequently, during product development phases, many failure mechanisms in laser modules have been identified. These failure mechanisms, if undetected, could result in very short laser lifetime in system use.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 62572-3:2011

Withd 2017

FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES – RELIABILITY STANDARDS –

Part 3: Laser modules used for telecommunication

1 Scope

This part of IEC 62572 deals with reliability assessment of laser modules used for telecommunication.

The aim of this standard is:

- to establish a standard method of assessing the reliability of laser modules in order to minimize risks and to promote product development and reliability;
- to establish means by which the distribution of failures with time can be determined. This should enable the determination of equipment failure rates for specified end of life criteria.

In addition, guidance is given in IEC/TR 62752-2:2008.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-1, *Environmental testing – Part 2-1: Tests – Test A: Cold*

IEC 60068-2-14, *Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60747-1, *Semiconductor devices – Part 1: General*

IEC 60749-1, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 1: General*

IEC/TR 62572-2:2008, *Fibre optic active components and devices – Reliability standards – Part 2: Laser module degradation*

ISO 9001, *Quality management and quality assurance standards*

MIL-STD-883, *Test methods and Procedures for Microelectronics*

3 Terms, definitions and symbols

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document the following definitions apply.

3.1.1

laser module

packaged assembly containing a laser diode and photodiode

NOTE The module may also include a cooler and temperature sensor to enable laser temperature to be controlled and monitored. The optical output is normally via an optical fibre pigtail.

3.1.2

submount

substrate upon which a laser diode or photodiode may be mounted for assembly into the laser module

NOTE Components on submounts are also subject to qualification testing.

3.1.3

laser module manufacturer

LMM

manufacturer of laser modules who provides devices meeting the requirements of the relevant specification and the customer's reliability requirements

3.1.4

system supplier

SS

manufacturer of telecommunications/data transmission equipment containing optoelectronic semiconductor lasers, i.e. laser module customer

3.1.5

system operator

SO

network operator of telecommunications/data transmission equipment containing optoelectronic semiconductor lasers in the transmission path

NOTE The system may also be part of other more extensive systems, for example telecommunications, rail, road vehicles, aerospace or weapons

3.1.6

capability qualifying components

CQC

components selected to represent critical stages of the process and limiting or boundary characteristics of mechanical and electro-optic design

NOTE Such components should aid the identification of end product failure mechanisms to enable the determination of activation energies.

3.2 Symbols

T_A	minimum storage temperature
T_B	maximum storage temperature
T_C	module case temperature
T_S	submount temperature
$T_{S \text{ nom}}$	recommended submount temperature
$T_{op \text{ min}}$	module minimum operating temperature
$T_{op \text{ max}}$	module maximum operating temperature
$T_{stg \text{ min}}$	module minimum storage temperature
$T_{stg \text{ max}}$	module maximum storage temperature
Qc	test for gross leak detection
Qk	test for fine leak detection
p	periodicity (in months)
n	sample size

4 Laser reliability and quality assurance procedure

4.1 Demonstration of product quality

This standard (where required by the specification) gives the minimum mandatory requirements and is part of a total laser reliability and quality assurance procedure adopted by the laser module manufacture.

It also gives guidance on the activities of the system supplier, and the system operator as well as feedback of field performance, the laser module manufacturer and the system supplier.

The laser module manufacturer shall be able to demonstrate, by means of qualification approval of devices, technology approval or capability approval of the manufacturing process:

- a) a documented and audited manufacturing process including the qualification of purchased components in accordance with ISO 9001;
- b) a performance qualification programme, including for example, accelerated life testing, burn-in and screening of components and modules;
- c) a qualification maintenance programme to ensure continuity of reliability performance;
- d) a procedure to feedback reliability issues to development and production.

4.2 Testing responsibilities

4.2.1 General

The testing detailed in Tables 1 and 2 is to be performed by the laser module manufacturer and component suppliers (where applicable). Additional testing may be specified in the specification.

4.2.2 Recommendation applicable to laser customer/system supplier

The system supplier is recommended to have a programme to analyse and verify the results including failure analysis. This programme includes an independent life test of fully packaged laser modules, see Table 2, Test 1 and/or Test 2 and 3 and/or Test 5 (sample size >10 per test).

4.2.3 Recommendation applicable to system operator

The system operator is recommended to have a programme to monitor and report field failure rates in sufficient detail to enable system supplier and laser module manufacturer to initiate any necessary corrective actions at an early stage in the lifetime of a product.

Suppliers may have different approaches (i.e. to reliability concepts) during the development of product maturity and resource limitations may dictate testing strategies.

Alternative tests and activities to those specified are permitted provided the LMM/SS/SO can show intent to remove end-product failures and the associated failure mechanisms. However, this will require significant data to substantiate compliance.

4.3 Quality improvement programmes (QIPs)

Quality improvement programmes (QIPs) shall be initiated with component suppliers and customers (SOs, SSs and LMMs) to address non-compliances (including quality and reliability problems identified during subsequent service life of the laser). The correction of non-compliances and subsequent QIPs are a required strategy to minimize reliability risks. The operation of QIPs should be stated in the quality approval (QA) generic and capability approval documents.

5 Tests

5.1 General

The tests described in Tables 1 and 2 are designed to accelerate the main failure mechanisms known to be reliability hazards in laser modules (see IEC/TR 62572-2:2008). Where appropriate, the CQC shall demonstrate an ability to reduce end product failure mechanisms. Final product validation is required to demonstrate that CQCs are operating at the boundaries of the process or technology. These tests will reduce the risk of unreliable components entering system use and will enable estimates to be made of the distribution of laser lifetimes and hence the laser failure rates.

The sample size and level of testing may vary depending on the business volume between the laser customer/system supplier (SS) and laser module manufacturer (LMM). This information will be given in the capability approval (CA) document and the specification where appropriate.

NOTE It is essential that the lasers evaluated are entirely representative of standard production devices, and have passed all the production and/or specified (where applicable in the specification) burn-in and screening procedures.

Table 1 – Initial qualification

These tests will normally be performed by the laser manufacturer as part of an initial qualification programme.

Table 2 – Maintenance of qualification

These tests cover periodic monitoring performed on production devices to ensure that the quality and reliability performance established during initial qualification is maintained or improved.

5.2 Structural similarity

Where a range of laser modules is produced by a laser manufacturer, there may be some significant structural similarity between different type codes. A combination of results from different test programmes, where appropriate, is therefore permitted.

Consideration should be given to the fact that minor differences in technology or processing can have a major impact on reliability, whilst not being apparent during quality assessment.

Evidence shall be presented which demonstrates that all results are directly relevant.

5.3 Burn-in and screening (when applicable in the specification)

NOTE See IEC/TR 62572-2:2008.

The screening test should be designed by the laser module manufacturer specifically for his particular technology. Any approach based on similarity to that which is performed by other manufacturers, is good for comparison purposes, but can be ineffective in achieving the actual screening goal. This is particularly true for fibre optic components whose technology is not yet mature and varies significantly from supplier to supplier.

Where a manufacturer can demonstrate component and process stability, screening procedures may be revised.

Table 1 – Initial qualification

Test No.	Test	IEC references	Conditions	n
1	Initial endurance test			
1.1	a) Module with thermoelectric cooler		Φ_e specified, constant power Temperature: $T_c = T_{op \max}$ $T_s = T_{s \text{ nom}}$ Duration: 5 000 h ^a	25
1.2	b) Module without thermoelectric cooler		Φ_e specified, constant power Temperature: $T_c = T_{op \max}$ Duration: 5 000 h ^a	25
1.3	Laser diode (submount)		Temperature: at least two test temperatures: Φ_e specified, constant power $T_{s1} = T_s \max$ $T_{s2} = < T_{s1} - 20 \text{ }^\circ\text{C}$ Duration: >5 000 h	200 See ^d See ^d
1.4	Photodiode (in representative package)		Temperature: at least two test temperatures: I_f or I_r specified $T_{s1} = 125 \text{ }^\circ\text{C min}^b$ $T_{s2} = < (T_{s1} - 30 \text{ }^\circ\text{C})$ Duration: >1 000 h	200 See ^d See ^d
1.5	High temperature storage of the thermoelectric cooler		$T = T_{stg \max}$ of the cooler Duration: 1 000 h	25
1.6	Power cycle tests cooled devices		Number of cycles: 20 K $T_c = T_{op \max}$ $T_s = T_c \text{ to } (T_c - \Delta T_{\max})$	25
1.7	High temperature storage of the thermal sensor		$T = T_{stg \max}$ of the sensor	25
2	Fibre test			
2.1	Fibre proof test		Proof test see ^d Duration see ^d Min. bend radius see ^d	10
2.2	Fibre retention	60749		
2.2.1	Fibre pull		Fibre pull see ^d	10
2.2.2	Side pull		Side pull see ^d	

Table 1 (continued)

Test No.	Test	IEC references	Conditions	n
3	Change of temperature		See ^c and ^d	10
3.1	Rapid change of temperature	60749	Temperature: $T_A = T_{\text{stg min}}$ $T_B = T_{\text{stg max}}$ Number of cycles = 50	
3.2	Temperature cycling	60749 60068-2-14	Temperature: $T_A = T_{\text{stg min}}$ $T_B = T_{\text{stg max}}$ > 1 °C/min Number of cycles = 500	10
4	Sealing	60749	See ^d Test Qk followed by Test Qc See ^c and ^d and A.6	10
5	Shock and vibration	60749	See A.7	10
5.1	Shock		500 G, 1 ms with Thermoelectric cooler, 1500 G, 0,5 ms without Thermoelectric cooler	
5.2	Vibration		6-direction, 5 times each 20 – 2000 Hz, 20 G, 3-direction, 30 min each	10
6	High temperature storage (not applicable if module life test performed at equivalent case temperature and submount temperature)	60749	Temperature: $T = T_{\text{stg max}}$ Duration: >2 000 h (See Table 5, IEC/TR 62752-2:2008)	10
7	ESDS, modules a) Lasers b) Photodiodes	60747-1 MIL-STD-883, Method 3015	Human body model, see A.9 5 discharges/test voltage, charge-discharge cycle > 0,1 s	5 per wafer
8	Residual gas analysis	MIL-STD-883, Method 1018	See ^d See A.10	6
9	Low temperature storage	60068-2-1	$T = T_{\text{stg min}}$ Duration: >1 000 h	10

^a Provided data about the distribution of wear-out lifetime is accumulated with sufficient accuracy. Provisional approval for product shipment shall be granted at 2 000 h. It is also recommended to continue the test until accurate extrapolation of lifetime is possible with an upper limit of 10 000 h. Durations up to 5 000 h may be needed for accurate lifetime prediction.

^b Or as limited by technology.

^c Results from Tests 1.1 and 1.2 shall be supplemented by a laser customer/SS independent test of fully packaged modules in accordance with Table 2, Test 2 and/or Test 3 (sample size ≥ 10 per test) see also 4.2.

^d Number of samples and conditions shall be determined by a laser customer/SS and LMM.

Table 2 – Maintenance of qualification

Test No.	Test	IEC references	Conditions	n	p
1	Ongoing reliability test a) Module (cooled) b) Module (uncooled) c) Laser diode (submount) d) Photodiode		Periodic testing: Test 1.1 Test 1.2 Test 1.3 Test 1.4	See NOTES 10 10 25 ^a 25 ^a	6
2	Temperature cycling	60749 60068-2-14	Temperature: $T_A = T_{\text{stg min}}$ $T_B = T_{\text{stg max}}$ > 1 ° C/min Periodic testing: Number of cycles = 200 (see NOTE 1)	10	6
3	Sealing	60749	see NOTE 2 Test Qk followed by Test Qs See NOTES and A.6	10	6
4	Shock and vibration	60749	See NOTES and A.7		12
4.1	Shock		500 G, 1 ms with thermoelectric cooler, 1500 G, 0,5 ms without thermoelectric cooler, 6 direction, 5 times each	10	
4.2	Vibration		20 – 2000 Hz, 20 G, 3-direction, 30 min each	10	
5	High temperature storage (not applicable if module life test performed at equivalent case temperature and submount temperature)	60749	Temperature: $T = T_{\text{stg max}}$ Duration: >2 000 h Periodic testing: see NOTES (See Clause 5 and Table 5, IEC/TR 62752-2)	10	12
6	ESDS, modules a) Lasers b) Photodiodes	MIL-STD-883, Method 3015	Periodic testing: see NOTES and A.9 Human body model 5 discharges/test voltage, Charge-discharge cycle > 0,1 s	5 per wafer	
7	Residual gas analysis	MIL-STD-883, Method 1018	See NOTE 2 Periodic testing: see NOTES and A.10	See NOTE 2	6

^a Out of different wafers.

NOTE 1 Results of Test 2 are supplemented by a laser customer/system supplier (SS) independent test of fully packaged modules in accordance with Table 2, Test 2 and/or Test 3 and/or Test 5 (sample size ≥ 10 per test). See also 4.2.

NOTE 2 Number of samples and conditions are determined by a laser customer/SS and LMM.

6 Activities

6.1 Analysis of reliability results

The laser module customer/system supplier (SS) shall have a programme to analyse and verify a laser manufacturer's reliability claims. In particular:

- life test data for the complete laser module;
- life test data for initial components, for example laser diode and photodiode;
- environmental test result, i.e. inspection requirements group B, C of the detail specification;
- where appropriate, see Clause 5, the data and test results of appropriate CQCs.

The analysis of results should lead to reporting of the laser module reliability parameters for each of the laser module types. Minimum reliability parameters are presented as in Table 3.

Where data reveals more than one wear-out mechanism, median life and dispersion in each case shall be stated.

The failure criteria used to derive these reliability parameters shall be agreed between the laser customer/system suppliers (SS) and laser module manufacturer (LMM). The criteria will be stated in the detail specification, see IEC/ TR 61752-2

Table 3 – Performance for laser module reliability parameters

Parameter	Measured value
Median life (ML) at 25 °C: see NOTE 3	Years
Dispersion(s)	
Wear-out failure rate at 5 years (λ) ₅	<u>FITs</u>
at 10 years (λ) ₁₀	<u>FITs</u>
at 20 years (λ) ₂₀	<u>FITs</u>
Wear-out activation energy	eV
Random failure rate (λ_a) @ 25 °C: see NOTE 3	<u>FITs</u>
Confidence limits used:	%
Random failure activation energy	eV
NOTE 1 This table assumes a log-normal distribution of times to failure. The dispersion parameter is the standard deviation of the logarithm to the base 'e' of the times to failure. See IEC/TR 62752-2:2.. NOTE 2 The reference temperature used for all parameters in this table is 25 °C. An alternative reference temperature (50 °C) may be used provided activation energies are given. NOTE 3 Special attention should be paid to all extrapolation models used and the justification for activation energies employed in reliability predictions is to be stated Guidance on these activities is given in IEC/TR 62752-2.	

6.2 Technical visits to LMMs

Laser module designs continue to evolve and a LMM may introduce significant changes which impinge on reliability. Under the negotiation between customer and manufacturer, technical visits should be performed until there is sufficient evidence of a maturing technology and

production stability. These technical meetings/visits shall contain an item on the agenda that concerns quality and reliability. Where a LMM holds a capability approval, the frequency of these technical visits may be reduced provided the manufacturer can demonstrate:

- a) that the CQCs fully represent any relevant design, process updates and reliability issues;
- b) satisfactory self-audit of the quality system.

6.3 Design/process changes

The customer/system supplier (SS) shall be informed by the laser module manufacturer (LMM) of any design or process change which may affect the form, fit or function of the end product.

6.4 Deliveries

Laser module designs will continue to evolve and therefore each delivered lot shall be manufactured according to a stated technology and production process.

This should be verified by the supplier/ and customer before delivery.

6.5 Supplier documentation

The laser customer/system supplier (SS) and component manufacturer or LMM shall incorporate, wherever possible, the tests and activities described in this standard into their in-house component qualification, or where appropriate, capability approval procedures and purchasing specifications. This documentation will be used in reliability/technical presentations, tender submission, marketing briefs to customers.

Annex A (informative)

Guidance on testing in Table 1 and Table 2

A.1 Laser module life tests containing thermoelectric coolers (for example, Peltier, Test 1.1, Table 1)

With laser modules containing thermoelectric coolers it is difficult to provide a significant degree of overstress to all key components simultaneously. During “normal operation”, the laser submount temperature is usually controlled at $T_s = 25\text{ °C}$. However, for a life test with a case temperature of $T_c = T_{op\ max}$, a useful stress can be obtained for the laser diode, fibre fixing, photodiode and thermal sensor if the cooler is operated at a relatively high current to maintain a submount temperature of $T_s = T_{s\ nom}$. The conditions in Table A.1 are recommended.

Some additional testing of the cooler is recommended, for example $T_c = T_{op\ max}$ and $T_s = T_s - 10\text{ °C}$.

Table A.1 – Recommended life test conditions for laser modules containing Peltier coolers

Case temperature	$T_{op\ max}$
Laser submount temperature	$T_s = T_{s\ nom}$
Optical power	Fibre output set to P_{max} at start of life test (using monitor circuit)
Laser current	To maintain constant monitor output
Monitor current	Normal bias
Thermal sensor current	Normal bias
Cooler current	To maintain constant thermistor resistance (or sensor conditions)
Duration	> 5 000 h

A.2 Laser module life tests – Uncooled module (Test 1.2, Table 1)

For modules without thermoelectric coolers (for example Peltier), life tests can be readily performed over a range of temperatures up to the recommended maximum operating temperature for the module. During initial qualification, service life tests at two or more temperatures, for example $T_c = T_{op\ max}$ and $T_c\ 40\text{ °C}$ to 50 °C , are recommended. Here, the accuracy of lifetime estimation becomes high in proportion to the number of test levels.

An additional life test at low temperature (duration > 2 000 h at $T_{op\ min}$) may be required for modules containing epoxies or organic materials.

If only a single life test is to be performed, for example during maintenance of qualification testing, the conditions in Table A.2 are recommended:

Table A.2 – Recommended life test conditions for uncooled laser modules

Case temperature	$T_{op \max}$
Optical power	Fibre output set to $P_{\max}$ at start of life test (using monitor circuit)
Laser current	To maintain constant monitor photocurrent
Monitor photocurrent	Normal bias
Duration	> 5 000 h

A.3 Laser diode life tests on submounts (Test 1.3, Table 1)

The laser life test shall be performed with the laser operating at constant light output, as it would be in normal operation, unless otherwise agreed with the ONS. Temperatures in the range $T_s = 50^\circ\text{C}$ to 80°C are often used. The acceleration in the rate of degradation, relative to normal operation, is therefore relatively small. The maximum temperature at which life tests can be performed under lasing operating conditions is usually in the range $T_s = 70^\circ\text{C}$ to 100°C . However, constant current/life tests at temperatures up to $T_s = 150^\circ\text{C}$ can be useful in studying the reliability of contact metallizations. Actual failures do not often occur in well screened laser diodes tested at temperatures $T_s < 90^\circ\text{C}$. In order to estimate the laser life some extrapolation is required to predict when the threshold or operating current will exceed the pre-determined failure criterion. To obtain a reasonable increase in operating current, a life test duration greater than 5 000 h is required.

If a single life test is to be performed, for example during maintenance of qualification testing, the conditions in Table A.3 are recommended:

Table A.3 – Recommended laser diode life test conditions

Temperature	$T_s = 70^\circ\text{C}$
Optical power	Maximum specified
Bias	To maintain constant monitor output
Duration	> 5 000 h

A.4 Monitor photodiode life tests (Test 1.4, Table 1)

Photodiode life tests are best performed with the devices under reverse bias if the susceptibility to increased dark current is to be assessed. To obtain failures in a reasonable timescale, temperatures in the range $T_s = 125^\circ\text{C}$ to 200°C are usually required. Devices with organic passivations should be tested at temperatures below the curing temperature of the passivation.

Increased bias voltage can also be used to accelerate failure, but the dependence of lifetime on voltage would then need to be determined before a prediction of operating lifetime could be made.

It is necessary for measurements of photodiode dark currents to include measurement at the normal operating temperature. Measurements made at only the life test temperature may not detect increased surface leakage, because bulk dark currents dominate at high temperatures.

Failed photodiodes with increased dark currents (as a result of the accumulation of mobile charge) will often recover quickly if stored at high temperatures without bias. It is essential, that at the end of the test duration, the reverse bias conditions shall be maintained until the

temperature is below 30 °C. The post test measurements shall be completed within 3 h. The increase in dark current of photodiodes with exposed junctions (for example unpassivated mesa devices) is very sensitive to the package atmosphere, and small traces of oxygen or water vapour can result in decreased lifetimes. Life tests should therefore be performed with the photodiodes sealed in representative hermetic packages, and not on open submounts. Tests in flowing (nominally dry) nitrogen can produce variable results. The conditions in Table A.4 are recommended.

Table A.4 – Recommended photodiode life test conditions

Temperature	In the range $T_s = 125\text{ °C}$ to 200 °C
Bias	Specified maximum reverse bias voltage. Bias to be maintained during cool down prior to measurements
Duration	1 000 h
Atmosphere	Photodiode in representative hermetic package

A.5 Temperature cycling and thermal shock (Test 3, Table 1 and Test 2, Table 2)

It is difficult to quantify the acceleration (with respect to normal operation) obtained from a temperature cycling test. Nevertheless, it has been clearly demonstrated that temperature cycling from $T_c = -40\text{ °C}$ to $+70\text{ °C}$ can reveal potentially serious hazards in laser modules associated with fibre instability, thermal mismatch between piece parts (for example coolers and submounts), and with fibre breaks.

For initial qualification, number of cycles = 500 from $T_{\text{stg min}}$ to $T_{\text{stg max}}$ are required. For periodic testing (3 and/or 6 monthly), number of cycles = 100. The temperature cycling procedure should follow either:

- a) IEC 60068-2-14, Test Na: two-chamber method;
- b) IEC 60068-2-14, Test Nb: single-chamber method, rate of change equal to 1, 3, or 5 °C/min.

Well designed and constructed modules should be able to withstand such a test with negligible changes in module performance.

A.6 Sealing/hermeticity (Test 4, Table 1 and Test 3, Table 2)

The post-test assessment for Test 4, Table 1 and Test 3, Table 2 shall be fine-leak testing, Test Qk, followed by the gross-leak Test Qa. Suitable precautions shall be taken to eliminate absorption of helium by the fibre coating to avoid measurement errors.

A.7 Shock and vibration (Test 5, Table 1 and Test 4, Table 2)

These tests are designed to simulate conditions involving vibration and shock that a component may be subjected to in service or during transportation. For a module with thermoelectric cooler the cooler is the limiting device, so the shock test should be limited to 500 G.

A.8 High-temperature storage (Test 6, Table 1 and Test 5, Table 2)

Temperature storage testing has the advantage of being relatively inexpensive because no bias circuitry is required. Provided the test is performed at or below the maximum storage

temperature for the module $T_c \leq T_{\text{stg max}}$, it can be regarded as non-destructive. Storage at high temperatures (for example $T_c = 70^\circ\text{C}$, duration = 1 000 h) will, although the stress is relatively small, provide useful protection against major problems with fibre alignment instability and will identify some potential metallization and solder failure mechanisms, for example thermoelectric cooler or thermistor failures.

A.9 Electrostatic discharge sensitivity (ESD) (Test 7, Table 1 and Test 6, Table 2)

Optoelectronic components are sensitive to damage by electrostatic discharge (ESD) at all stages during manufacture, testing, assembly into equipment and operation. Exposure to ESD can result in sudden failure, parametric shifts, or even latent damage leading to a reduced lifetime during subsequent operation. The sensitivity of the laser and monitor photodiode to ESD damage should be determined so that the appropriate level of precautions can be taken to avoid damage.

The minimum recommended testing for modules is to subject six laser diodes and six monitor photodiodes on a wafer basis, to the "human body model" test described in MIL-STD-883, method 3015. However, rather than applying a single go-no-go test condition, transients of increasing voltage should be applied to determine the threshold at which failures occur.

Failure should be defined as a parametric change in:

- photodiode dark current or in laser threshold current;
- slope efficiency;
- forward voltage;
- reverse leakage current or light output spectrum.

The criteria are given in IEC/TR 62752-2:2008, Table 3.

A.10 Residual gas analysis (RGA) (Test 8, Table 1 and Test 7, Table 2)

Certain laser module reliability hazards associated with high package water content are unlikely to be detected with the testing described in Tables 1 and 2. Hermeticity testing and residual gas analysis of transmitter modules is necessary to demonstrate that the module package contains a dry, inert atmosphere throughout its operating life. High-temperature life testing alone is not likely to detect reliability hazards associated with high package water content. See also A.2 and Tables 1 and 2, Test 7.

Caution: the pre-bake temperature for RGA in MIL-STD-883, method 1018 is 120°C . This may be greater than the storage temperature $T_{\text{stg max}}$ of most optoelectronic components. A lower pre-bake temperature of $T_c = T_{\text{stg max}}$ for a longer period is therefore recommended until the background level of RGA remains constant. This level can then be eliminated from the results.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 62512-3:2017

Withd2wn

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	21
INTRODUCTION.....	23
1 Domaine d'application	24
2 Références normatives.....	24
3 Termes, définitions et symboles	24
3.1 Termes et définitions	24
3.2 Symboles	25
4 Fiabilité du laser et procédure d'assurance de la qualité.....	26
4.1 Démonstration de la qualité du produit	26
4.2 Responsabilité des essais	26
4.2.1 Généralités.....	26
4.2.2 Recommandation applicable au client du laser/fournisseur du système.....	26
4.2.3 Recommandation applicable à l'opérateur du système.....	26
4.3 Programmes d'amélioration de la qualité (QIP).....	27
5 Essais	27
5.1 Généralités.....	27
5.2 Associativité.....	28
5.3 Vieillesse artificielle et déverminage (s'ils sont applicables dans la spécification).....	28
6 Activités	32
6.1 Analyse des résultats de fiabilité	32
6.2 Visites techniques aux LMM.....	33
6.3 Changements au niveau de la conception/du processus.....	33
6.4 Livraisons.....	33
6.5 Documentation fournisseur.....	33
Annexe A (informative) Lignes directrices concernant les essais dans les Tableaux 1 et 2...34	
Tableau 1 – Qualification initiale	29
Tableau 2 – Maintien de la qualification	31
Tableau 3 – Performances des paramètres de fiabilité des modules laser.....	32
Tableau A.1 – Conditions d'essai d'endurance recommandées pour les modules laser dotés de refroidisseurs	34
Tableau A.2 – Conditions d'essai d'endurance recommandées pour les modules laser non refroidis	35
Tableau A.3 – Conditions recommandées pour l'essai d'endurance sur diode laser	35
Tableau A.4 – Conditions recommandées d'essai d'endurance sur photodiodes	36

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS EN FIBRES OPTIQUES –
NORMES DE FIABILITÉ –****Partie 3: Modules laser utilisés pour les télécommunications****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62572-3 a été établie par le sous-comité 86C: Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
86C/1022/FDIS	86C/1035/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de la présente norme.

La présente publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 62572-3:2011

Withdrawn

INTRODUCTION

Les modules laser couverts par la présente norme internationale sont approvisionnés par des fournisseurs de systèmes (SS¹) pour être insérés dans un matériel lui-même fourni/vendu à un opérateur du système (SO²) ou à un exploitant de réseau (les définitions sont données à l'Article 3).

Pour que l'opérateur du système se comporte en acheteur averti, une connaissance des risques potentiels posés par l'utilisation de composants critiques est nécessaire.

Les techniques relatives aux composants optoélectroniques sont en constante évolution. Par conséquent, au cours des phases de développement des produits, de nombreux mécanismes de défaillance ont été identifiés au sein des modules laser. Ces mécanismes de défaillance, s'ils ne sont pas détectés, pourraient occasionner des durées de vie du laser très courtes au niveau de l'utilisation du système.

¹ SS = *System supplier*.

² SO = *System operator*.

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS EN FIBRES OPTIQUES – NORMES DE FIABILITÉ –

Partie 3: Modules laser utilisés pour les télécommunications

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 62572 s'applique à l'évaluation de la fiabilité des modules laser utilisés pour les télécommunications.

La présente norme a pour objet:

- d'établir une méthode normalisée permettant d'évaluer la fiabilité des modules laser afin de minimiser les risques et de favoriser le développement et la fiabilité des produits;
- d'établir des moyens permettant de déterminer la répartition des défaillances au fil du temps. Ceci devrait permettre de déterminer les taux de défaillance du matériel pour les critères de fin de vie spécifiés.

En outre, des lignes directrices sont données dans la CEI/TR 62752-2:2008.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60068-2-1, *Essais d'environnement – Partie 2-1: Essais – Essai A: Froid*

CEI 60068-2-14, *Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essai N: Variation de température*

CEI 60747-1, *Dispositifs à semiconducteurs – Partie 1: Généralités*

CEI 60749-1, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 1: Généralités*

IEC/TR 62572-2:2008, *Fibre optic active components and devices – Reliability standards – Part 2: Laser module degradation* (disponible en anglais seulement)

ISO 9001, *Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire*

MIL-STD-883, *Test methods and Procedures for Microelectronics* (disponible en anglais seulement)

3 Termes, définitions et symboles

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1.1

module laser

composant constitué de l'assemblage d'une diode laser et d'une photodiode

NOTE Il est permis que le module inclue aussi un refroidisseur et un capteur de température permettant de contrôler et de surveiller la température du laser. La sortie optique se fait normalement par une fibre amorce.

3.1.2

support

substrat sur lequel peut être monté une diode laser ou une photodiode en vue d'être assemblé dans un module laser

NOTE Les composants sur ces supports sont également soumis à un essai de qualification.

3.1.3

fabricant de modules laser

LMM³

fabricant de modules laser fournissant des dispositifs répondant aux exigences de la spécification applicable et aux exigences de fiabilité du client

3.1.4

fournisseur du système

SS⁴

fabricant de matériel de transmission de données/télécommunications comprenant des lasers à semi-conducteurs optoélectroniques, c'est-à-dire client de modules laser

3.1.5

opérateur du système

SO⁵

exploitant de réseau utilisant du matériel de transmission de données/télécommunications comprenant des lasers à semi-conducteurs optoélectroniques au niveau des voies de transmission

NOTE Il est permis que le système s'intègre dans d'autres systèmes plus étendus, par exemple les télécommunications, les transports ferroviaires, les véhicules routiers, l'aérospatiale ou l'armement.

3.1.6

composants pour agrément savoir-faire

CQC⁶

composants sélectionnés pour supporter les étapes critiques du processus et les caractéristiques restrictives propres à une conception mécanique et électro-optique.

NOTE Il convient que ces composants servent à identifier les mécanismes de défaillance du produit final permettant de déterminer les énergies d'activation.

3.2 Symboles

T_A	température minimale de stockage
T_B	température maximale de stockage
T_C	température du boîtier du module
T_S	température du support
$T_{S \text{ nom}}$	température du support recommandée
$T_{op \text{ min}}$	température minimale du boîtier en fonctionnement

³ LMM = Laser Module Manufacturer.

⁴ SS = System Supplier.

⁵ SO = System Operator.

⁶ CQC = Capability Qualifying Components.

$T_{op\ max}$	température maximale du boîtier en fonctionnement
$T_{stg\ min}$	température minimale de stockage du module
$T_{stg\ max}$	température maximale de stockage du module
Qc	essai de détection de fuite importante
Qk	essai de détection de fuite fine
p	périodicité (en mois)
n	taille d'échantillons

4 Fiabilité du laser et procédure d'assurance de la qualité

4.1 Démonstration de la qualité du produit

La présente norme (quand elle est prescrite par spécification) indique les exigences obligatoires minimales et s'intègre dans une procédure de fiabilité totale du laser et d'assurance de la qualité adoptée par le fabricant du module laser.

Elle donne également des lignes directrices concernant les activités du fournisseur du système, de l'opérateur du système ainsi que le retour d'expérience au niveau de la performance sur le terrain vis-à-vis du fabricant de module laser et du fournisseur du système.

Moyennant une homologation de dispositifs, un agrément de technologie ou un agrément de savoir-faire du processus de fabrication, le fabricant de modules laser doit être capable de présenter:

- a) un processus de fabrication documenté et audité comprenant la qualification de composants approvisionnés conformément à l'ISO 9001;
- b) un programme de qualification de performance, comprenant par exemple, les essais d'endurance accélérée, le vieillissement artificiel et le déverminage de composants et de modules;
- c) un programme de maintien de la qualification permettant d'assurer la continuité de la performance de fiabilité;
- d) une procédure permettant de renvoyer les problèmes de fiabilité au niveau du développement et de la production.

4.2 Responsabilité des essais

4.2.1 Généralités

Il faut que les essais détaillés dans les Tableaux 1 et 2 soient réalisés par le fabricant de modules laser et par les fournisseurs de composants (le cas échéant). Des essais supplémentaires sont susceptibles d'être spécifiés dans la spécification.

4.2.2 Recommandation applicable au client du laser/fournisseur du système

Il est recommandé que le fournisseur du système ait un programme permettant l'analyse et la vérification des résultats d'essais, y compris l'analyse des défaillances. Ce programme comprend un essai d'endurance indépendant réalisé sur des modules laser prêts à être utilisés, voir Tableau 2, Essai 1 et/ou Essai 2 et 3 et/ou Essai 5 (taille de l'échantillonnage > 10 par essai).

4.2.3 Recommandation applicable à l'opérateur du système

Il est recommandé que l'opérateur du système ait un programme permettant de contrôler et de signaler les taux de défaillance sur le terrain avec suffisamment de détails pour permettre au fournisseur du système ainsi qu'au fabricant de modules laser de lancer toute action corrective nécessaire à un stade précoce de la durée de vie d'un produit.

Il est admis que les fournisseurs aient des approches différentes (au niveau des concepts de fiabilité) au cours du développement de la maturité du produit, et que des limitations de ressources dictent les stratégies d'essai.

Il est permis de pratiquer des essais et des activités différents de ceux spécifiés à condition que les LMM/SS/SO puissent démontrer leur intention de supprimer les défaillances du produit final et les mécanismes de défaillance associés. Cependant, des données significatives seront nécessaires pour justifier la conformité.

4.3 Programmes d'amélioration de la qualité (QIP⁷)

Des programmes d'amélioration de la qualité (QIP) doivent être lancés par les fournisseurs et les clients des composants (SO, SS et LMM) afin de faire face aux non-conformités (y compris les problèmes de qualité et de fiabilité identifiés lors de la durée d'utilisation ultérieure du laser). La correction des non-conformités et le QIP résultant constituent une stratégie nécessaire pour minimiser les risques concernant la fiabilité. Il convient d'indiquer le déroulement des QIP dans les documents génériques d'agrément de la qualité (QA⁸) et les documents d'agrément de savoir-faire.

5 Essais

5.1 Généralités

Les essais décrits dans les Tableaux 1 et 2 sont conçus pour accélérer les principaux mécanismes de défaillance connus pour représenter des risques au niveau de la fiabilité des modules laser, (voir CEI/TR 62752-2:2008). Le cas échéant, le CQC doit démontrer une aptitude à réduire les mécanismes de défaillance du produit final. La validation du produit final est nécessaire pour prouver que les CQC fonctionnent dans les limites du processus ou de la technologie. Ces essais réduiront le risque que représentent des composants non fiables pénétrant dans le système et permettront de faire des estimations au niveau de la répartition des durées de vie du laser et par conséquent des taux de défaillance du laser.

La taille de l'échantillon et le niveau d'essai sont susceptibles de varier en fonction du volume d'échanges entre le client du laser ou le fournisseur du système (SS), et le fabricant du modules laser (LMM). Ces informations seront indiquées dans le document d'agrément de savoir-faire (CA⁹) et la spécification, le cas échéant.

NOTE Il est primordial que les lasers évalués soient entièrement représentatifs des dispositifs de production normalisés, et qu'ils aient subi toutes les procédures de production et/ou de vieillissement artificiel et de déverminage spécifiées (si elles s'appliquent dans la spécification).

Tableau 1 – Qualification initiale

Ces essais seront normalement réalisés par le fabricant du laser comme partie intégrante d'un programme de qualification initial.

Tableau 2 – Maintien de la qualification

Ces essais couvrent la surveillance périodique exercée sur les dispositifs de production afin d'assurer le maintien ou l'amélioration de la qualité et des performances de fiabilité établies au cours de la qualification initiale.

⁷ QIP = Quality improvement programme.

⁸ QA = Quality approval.

⁹ CA = Capability approval.

5.2 Associativité

Quand une gamme de modules laser est produite par un fabricant de lasers, une associativité significative est admise entre différents codes type. Une combinaison de résultats de différents programmes d'essai, le cas échéant, est par conséquent autorisée.

Il convient de prendre en compte le fait que des différences mineures au niveau des techniques ou du traitement peuvent avoir un impact majeur sur la fiabilité, alors que ce fait n'est pas apparent au cours de l'évaluation de la qualité.

Des preuves doivent être présentées, démontrant que tous les résultats sont directement applicables.

5.3 Vieillessement artificiel et déverminage (s'ils sont applicables dans la spécification)

NOTE Voir CEI/TR 62572-2:2008.

Il convient que l'essai de déverminage soit conçu par le fabricant de modules laser spécifiquement pour sa technologie particulière. Toute approche fondée sur une similarité avec les réalisations d'autres fabricants permet d'établir des comparaisons, mais elle peut être inefficace pour atteindre l'objectif de déverminage réel. C'est le cas particulièrement pour les composants pour fibres optiques dont les technologies ne sont pas encore stabilisées et varient de façon significative d'un fabricant à l'autre.

Quand un fabricant peut démontrer une stabilité des composants et des processus, une révision des procédures de déverminage est permise.

Tableau 1 – Qualification initiale

Essai N°	Essai	Référence CEI	Conditions	n
1	Essai d'endurance initial			
1.1	a) Module avec refroidisseur thermo-électrique		Φ_e spécifié, puissance constante Température: $T_c = T_{op\ max}$ $T_s = T_{s\ nom}$ Durée: 5 000 h ^a	25
1.2	b) Module sans refroidisseur thermo-électrique		Φ_e spécifié, puissance constante Température: $T_c = T_{op\ max}$ Durée: 5 000 h ^a	25
1.3	Diodes laser (support)		Température: au moins deux températures d'essai: Φ_e spécifié, puissance constante $T_{s1} = T_{s\ max}$ $T_{s2} = < T_{s1} - 20\ ^\circ C$ Durée: > 5 000 h	200 Voir ^d Voir ^d
1.4	Photodiode (d'une série représentative)		Température: au moins deux températures d'essai: V_r ou I_r spécifié $T_{s1} = 125\ ^\circ C\ min\ ^b$ $T_{s2} = < (T_{s1} - 30\ ^\circ C)$ Durée: > 1 000 h	200 Voir ^d Voir ^d
1.5	Température élevée, stockage du refroidisseur thermo-électrique		$T = T_{stg\ max}$ du refroidisseur Durée: 1 000 h	25
1.6	Essais de cycle de puissance dispositifs refroidis		Nombre de cycles: 20 K $T_c = T_{op\ max}$ $T_s = T_c\ to\ (T_c - \Delta T_{max})$	25
1.7	Température élevée, stockage du capteur thermique		$T = T_{stg\ max}$ du capteur	25
2	Essai de la fibre			
2.1	Essai de résistance de la fibre		Essai de résistance Voir ^d Durée Voir ^d Rayon de courbure min Voir ^d	10
2.2	Retenue de la fibre	60749		
2.2.1	Traction de la fibre		Traction de la fibre Voir ^d	10
2.2.2	Traction latérale		Traction latérale Voir ^d	

Tableau 1 (suite)

Essai N°	Essai	Référence CEI	Conditions	n
3	Variations de température		Voir ^c et ^d	10
3.1	Variations rapides de température	60749	Température: $T_A = T_{\text{stg min}}$ $T_B = T_{\text{stg max}}$ Nombre de cycles = 50	
3.2	Cycles de températures	60749 60068-2-14	Température: $T_A = T_{\text{stg min}}$ $T_B = T_{\text{stg max}}$ > 1 °C/min Nombre de cycles = 500	10
4	Étanchéité	60749	Voir ^d Essai Qk suivi de l'essai Qc Voir ^c et ^d et A.6	10
5	Chocs et vibrations	60749	Voir A.7	10
5.1	Chocs		500 G, 1 ms avec refroidisseur thermo-électrique 1500 G, 0,5 ms sans refroidisseur thermo-électrique	
5.2	Vibrations		6-directions, 5 fois chacune 20 – 2000 Hz, 20 G, 3-directions, 30 minutes chacune	10
6	Stockage à haute température (non applicable si essai d'endurance du module réalisé à température de boîtier et support équivalente)	60749	Température: $T = T_{\text{stg max}}$ Durée: >2 000 h (Voir Tableau 5, CEI/TR 62752-2:2008)	10
7	ESDS, modules a) Lasers b) Photodiodes	60747-1 MIL-STD-883, Méthode 3015	Modèle du corps humain, voir A.9 5 décharges/tension d'essai Cycle de charge-décharge > 0,1 s	5 par plaquette
8	Analyse des gaz résiduels	MIL-STD-883, Méthode 1018	Voir ^d Voir A.10	6
9	Stockage à basse température	60068-2-1	$T = T_{\text{stg min}}$ Durée: >1 000 h	10

^a A condition que les données relatives à la répartition de la période de défaillance par usure soient réunies avec une précision suffisante. Un agrément provisoire pour l'expédition du produit doit être accordé après 2 000 h. Il est aussi recommandé de poursuivre l'essai jusqu'à ce qu'une extrapolation précise de la durée de vie soit possible avec une limite supérieure de 10 000 h. Des durées atteignant 5 000 h sont susceptibles d'être nécessaires pour prévoir avec précision la durée de vie.

^b Ou selon les limites techniques.

^c Les résultats des essais 1.1 et 1.2 doivent être complétés par un essai réalisé indépendamment par le client du laser/SS sur les modules prêts à l'utilisation conformément à l'essai 2 et/ou 3 du Tableau 2 (taille de l'échantillon ≥ 10 par essai), voir également 4.2.

^d Le nombre d'échantillons et les conditions doivent être déterminés par le client du laser/SS et le LMM.

Tableau 2 – Maintien de la qualification

Essai N°	Essai	Référence CEI	Conditions	n	p
1	Essai de fiabilité continue a) Module (refroidi) b) Module (non refroidi) c) Diode laser (support) d) Photodiode		Essai périodique: Essai 1.1 Essai 1.2 Essai 1.3 Essai 1.4	Voir NOTES 10 10 25 ^a 25 ^a	6
2	Cycle de température	60749 60068-2-14	Température: $T_A = T_{stg \text{ min}}$ $T_B = T_{stg \text{ max}}$ > 1° C/min Essai périodique: Nombre de cycles = 200 (voir NOTE 1)	10	6
3	Étanchéité	60749	Voir NOTE 2 Essai Qk suivi de l'essai Qc Voir NOTES et A.6	10	6
4	Chocs et vibrations	60749	Voir NOTES et A.7		12
4.1	Chocs		500 G, 1 ms avec refroidisseur thermo-électrique 1500 G, 0,5 ms sans refroidisseur thermo-électrique 6-directions, 5 fois chacune 20 – 2000 Hz, 20 G,	10 10	
4.2	Vibrations		3-directions, 30 minutes chacune		
5	Stockage à haute température (non applicable si essai d'endurance du module réalisé à température de boîtier et support équivalente)	60749	Température: $T = T_{stg \text{ max}}$ Durée: >2 000 h Essai périodique: Voir NOTES (Voir Article 5 et Tableau 5, CEI/TR 62752-2)	10	12
6	ESDS, modules a) Lasers b) Photodiodes	MIL-STD-883, Méthode 3015	Essai périodique: Voir NOTES et A.9 Modèle du corps humain 5 décharges/tension d'essai Cycle de charge-décharge > 0,1 s	5 par plaquette	
7	Analyse des gaz résiduels	MIL-STD-883, Méthode 1018	Voir NOTE 2 Essai périodique: Voir NOTES et A.10	Voir NOTE 2	6
^a Parmi différentes plaquettes.					
NOTE 1 Il faut que les résultats de l'essai 2 soient complétés par un essai réalisé indépendamment par le client du laser/SS sur les modules prêts à l'utilisation conformément au Tableau 2, Essai 2 et/ou Essai 3 et/ou Essai 5 (taille de l'échantillon ≥ 10 par essai). Voir également 4.2.					
NOTE 2 Le nombre d'échantillons et les conditions sont déterminés par le client du laser/SS et le LMM.					